当地时间5月28日，马来西亚公布了一项国家半导体战略（National Semiconductor Strategy，简称NSS），旨在推动该国半导体行业发展，吸引高价值投资，以促进与东盟、亚洲和全球企业合作。  
  
  
据介绍，该计划由马来西亚投资、贸易暨工业部（MITI，简称投贸部）领导，并涉及多个部门，是一项稳健、灵活、包容且具有前瞻性的战略。  
  
  
马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣（Anwar Ibrahim）表示，希望通过NSS战略吸引上千亿美元的半导体相关投资，从而将马来西亚打造成全球半导体研发中心。为此，马来西亚政府将拨款250亿林吉特(约53.3亿美元)落实NSS计划，并为60,000名马来西亚高技能工程师提供培训和提升技能。  
  
  
NSS战略将分3个阶段实施，其中第一阶段预计将积极争取5,000亿林吉特(约1,070亿美元)的投资，其中国内直接投资重点关注积集成电路(IC)设计、先进封装与制造设备，以及专注于晶圆厂和制造设备的外国直接投资。一旦落实第一阶段，马来西亚有望吸引更多先进芯片制造商。  
  
  
第二阶段的重点在于走向前沿，追求存储芯片的设计、制造与测试，并寻求整合芯片购买者。至第二阶段，马来西亚将重点培育至少10家营收在10亿~47亿林吉特的设计与先进封装企业，同时还计划培育至少100家营收接近10亿林吉特的半导体相关企业。  
  
  
第三阶段的重点则是前沿创新，支持马来西亚在半导体设计、先进封装与制造设备领域发展世界一流的企业，同时吸引苹果、华为和联想等尖端企业进驻来马来西亚。  
  
  
当前，马来西亚是全球半导体产业的主要参与者，占全球封测市场约13%。据全球半导体观察此前不完全统计，马来西亚已经吸引了包括英特尔、美光、德州仪器、恩智浦、日月光、安世半导体、英飞凌、华天科技、通富微电、苏州固锝、瑞萨电子、安森美、安靠、意法半导体等在内的约50家半导体企业入驻。



封面图片来源：拍信网